

2022-2028年中国COF行业 发展态势与投资战略咨询报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国COF行业发展态势与投资战略咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202207/310576.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

COF (Chip On Flex , or , Chip On Film) , 常称覆晶薄膜 , 是将集成电路 (IC) 固定在柔性线路板上的晶粒软膜构装技术 , 运用软质附加电路板作为封装芯片载体将芯片与软性基板电路结合 , 或者单指未封装芯片的软质附加电路板 , 包括卷带式封装生产 (TAB基板 , 其制程称为TCP) 、 软板连接芯片组件、软质IC载板封装。

中企顾问网发布的《2022-2028年中国COF行业发展态势与投资战略咨询报告》共八章。首先介绍了COF行业市场发展环境、COF整体运行态势等 , 接着分析了COF行业市场运行的现状 , 然后介绍了COF市场竞争格局。随后 , 报告对COF做了重点企业经营状况分析 , 最后分析了COF行业发展趋势与投资预测。您若想对COF产业有个系统的了解或者想投资COF行业 , 本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据 , 海关总署 , 问卷调查数据 , 商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局 , 部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据 , 企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等 , 价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录 :

第一章 COF产品概述

第一节 COF的定义

第二节 COF品种

第三节 COF——目前的主流挠性IC封装形式

一、IC封装

二、IC封装基板与常规印制电路板在性能、功能上的差异

三、IC封装基板的种类

第四节 COF与TAB、TCP、TAPE BGA/CSP在定义上的区别

第五节 COF在驱动IC中的应用

第六节 COF行业与市场发展概述

第二章 COF的结构及其特性

第一节 COF的结构特点

第二节 COF在LCD驱动IC应用中的特性

第三节 COF与其它IC驱动IC封装形式的应用特性对比

一、COF与COG比较

二、COF与TAB比较

第四节 未来COF在结构及其特性上的发展前景

一、制作线宽/线距小于 $30\mu\text{m}$ 的精细线路封装基板

二、卷式（ROLL TO ROLL）生产方式的发展

三、多芯片组装（MCM）形式的COF

第五节 COF的更高阶封装形式——基于挠性基板的3D封装的发展

一、从2D发展到3D的挠性基板封装

二、基于挠性基板的3D封装的主要形式

第三章 驱动IC产业现状与发展

第一节 驱动IC的功能与结构

一、驱动IC的功能及与COF的关系

1、驱动IC的功能

2、驱动IC与COF的关系

二、驱动IC的结构

三、驱动IC的品种

第二节 驱动IC在发展LCD中具有重要的地位

第三节 大尺寸TFT-LCD驱动及其特点

一、大尺寸TFT-LCD驱动特点

二、大尺寸TFT-LCD驱动芯片设计难点

第四节 驱动IC产业的特点

第五节 世界显示驱动IC的市场现况

一、显示驱动IC制造厂商与下游LCD面板厂家的关系及分析

二、世界显示驱动IC设计业现况

三、世界显示驱动IC市场规模调查统计

第六节 世界显示驱动IC主要生产厂家的现况

第四章 液晶面板应用市场现状与发展

第一节 世界液晶面板市场规模与生产情况概述

一、世界液晶面板市场变化

二、世界面板市场品种的格局

三、台、中、日、韩面板产业发展及趋势分析

第二节 世界大尺寸TFT-LCD应用市场发展现况

- 一、世界大尺寸面板市场规模总述
- 二、液晶电视领域对大尺寸面板的需求情况
- 三、平板电脑领域对大尺寸面板的需求情况
- 四、显示器领域对大尺寸面板的需求情况
- 五、对2020年世界大尺寸面板市场需求的预测

第三节 我国液晶面板市场规模与生产情况概述

- 一、我国驱动IC设计行业的情况
- 二、我国液晶面板产业的发展
- 三、我国液晶面板生产现况与未来发展预测

第五章 COF的生产工艺及技术的发展

第一节 COF制造技术总述

- 一、COF的问世
- 二、COF的技术构成

第二节 COF挠性基板的生产工艺技术

- 一、COF挠性基板生产的工艺过程总述及工艺特点
- 二、挠性基板材料的选择
- 三、精细线路的制作

第三节 IC芯片的安装技术

第四节 COF挠性基板的主要性能指标

第六章 世界COF基板的生产现状

第一节 全世界COF基板生产量统计

第二节 全世界COF市场格局

第三节 全世界COF基板主要生产厂家

第四节 全世界COF基板主要生产情况

- 一、日本COF基板厂家
- 二、韩国COF基板厂家
 - 1、韩国LG MICRON
 - 2、韩国STEMCO
- 三、台湾COF基板厂家

- 1、台湾欣邦
- 2、台湾易华

第七章 我国COF基板的生产现状

第一节 我国FPC业的现状

第二节 我国COF的生产现状

第三节 我国COF基板的生产企业现状

一、国内COF基板生产企业发展概述

二、深圳丹邦科技股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、COF相关产业发展概况
- 3、企业经营情况
- 4、核心优势及发展战略

三、三德冠精密电路科技有限公司

- 1、企业概况
- 2、COF相关产业发展概况
- 3、企业经营情况
- 4、核心优势及发展战略

四、上达电子（深圳）股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、COF产业发展概况
- 3、企业经营情况
- 4、核心优势及发展战略

五、厦门弘信电子科技股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、COF产业发展概况
- 3、企业经营情况
- 4、核心优势及发展战略

第八章 COF挠性基板用二层型挠性覆铜板特性与生产现状

第一节 二层型挠性覆铜板品种及特性

第二节 挠性覆铜板产品主要采用的标准及性能要求

一、适用于FCCL的中国国家标准介绍

二、国际上广泛使用的FCCL标准介绍

1、IPC标准

2、IEC标准

3、日本标准

4、测试方法比较

三、实际产品应用中的性能要求

第三节 挠性覆铜板的生产工艺

一、三层型挠性覆铜板的生产工艺

1、片状制造法

2、卷状制造法

二、二层型挠性覆铜板的生产工艺

1、涂布法（CASTING）

2、层压法（LAMINATION）

3、溅镀法（SPUTTERING/PLATING）

第四节 世界挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家

一、总述

二、日本FCCL业生产现状与发展

三、美国、欧洲FCCL业的现状与发展

四、台湾FCCL业的现状与发展

五、韩国FCCL业的现状与发展

第五节 我国国内挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家

一、我国国内挠性覆铜板业发展总述

二、我国国内挠性覆铜板生产厂家现况

图表目录：

图表1：三种封装基板的CTE及对CCL的CTE要求

图表2：COF与COG比较分析

图表3：COF与TAB比较分析

图表4：2016-2020年世界显示驱动IC市场规模调查统计

图表5：世界显示驱动IC主要生产厂家的分析

图表6：2016-2020年全球主流面板厂商分区域销售额走势（单位：十亿美元）

图表 7：2016-2020年全球大尺寸面板出货数量及同比走势（单位：百万台，%）

图表 8：2016-2020年全球大尺寸面板分应用平均尺寸走势（单位：英寸）

图表 9：2022-2028年全球液晶电视面板平均尺寸走势（单位：英寸）

图表 10：2022-2028年全球液晶电视面板分分辨率占比走势（%）

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202207/310576.html>